

株式会社東京精密 2022年度(2023年3月期) 第2四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2022年11月2日 開催

1. 本資料は、上記日時に開催された2022年度(2023年3月期) 第2四半期決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
2. 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
3. なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. **2Qの受注高が8月時点の見通しを下振れたと理解するが、要因を聞きたい。**
 - SPEは、SiCやパワー半導体関連需要はあるが、民生、特に携帯電話関連が相当落ち込んでいることが主因。ただ、上期受注は期初想定した水準に達している。
 - 計測は、1Qに価格改定前の駆け込み、納期確定を目的とする顧客の早期発注が多く、2Qにその反動減が想定以上に出たことによる。
2. **上期のプロローバ受注構成比(60%前半)は、前年同期比で上昇している。昨今の状況を踏まえると、逆に加工装置比率が上昇する可能性もあったのではないか。**
 - 5月説明会のコメント通り、民生向け加工装置需要は、2021年度後半から減少している。一方、プロローバ需要は堅調だった。長期では、Advanced Package向け等の加工関連需要により、加工装置比率が上昇すると想定する。
3. **2QのSPE受注高に占めるパワー半導体関連の比率は?**
 - パワー半導体向け受注比率は10%半ば。このほか、パワー半導体用のウェーハ用研削装置の比率を含めると20%半ばになると考える。
4. **直近のSPE消耗品受注・売上動向は?**
 - 2021年度の消耗品規模は年間40億円後半～50億円であり、当上期は、概ね同水準である。ダイサ本体の需要減少、当社が強み有する携帯電話関連の需要減少によるダイシングブレードの伸び悩みがある一方で、研削装置用の砥石が伸びてい

る。特に SiC 用砥石では、今後伸びれば年 2 億円程度の押し上げとなる。消耗品全体で年間 70-80 億円の売上まで伸ばしてゆきたい。

5. **1Q 受注高・受注残高の修正に至った原因と財務諸表への影響を聞きたい。**
 - 受注高・受注残高のみの修正であり、売上高・各利益への影響はない。
 - 原因は、連結計算過程で子会社の誤った報告において計算され、親会社側のチェックでも見逃したため。

6. **研削装置について、競合他社製品と比べどのような比較をされているか。**
 - 当社の強みは超高剛性にあり、硬い材料の研削が可能であると考ええる。

7. **韓国メーカーがブレードダイサの展開を開始したが、当社の見解は。**
 - 参入したことは認識している。競争で劣後しないよう、優位性のある機能開発を続ける。

8. **部材逼迫について、現在不足している部品の内容や、改善の兆しの有無を聞きたい。**
 - 部材により改善傾向があるもの、逆により調達困難になったものがある。現在調達困難なのは、モータやセラミックス部品、ならび半導体関連である。

9. **2022 年度通期売上高・営業利益予想を引き下げている。この要因を解説頂きたい。**
 - SPE 売上高修正：受注残高は高水準であり、要求納期通りの出荷が進めば前回予想を据え置けるが、足許の受注キャンセル・納期延伸に係る生産スロットの調整を懸念した。生産スロットの調整が発生した場合、部材調達計画も変更される。11 月現在、これらは調整可能な水準にあるが、納期延伸が 4Q 以降に発生した場合、調整が困難となる可能性があるため、これを踏まえた修正を行った。
 - 計測売上高修正：業界統計が示す通り、市場全体が緩やかな回復傾向にあることを踏まえたもの。
 - 営業利益修正：部材価格の高騰が、足許では円安によりほぼ相殺されているが、割高な市場部品の調達が必要な状況がつづくほか、通常調達部品の値上げ要請も増えている。さらに固定費も、賃金上昇などによる増加を想定している。
 - 部材価格の製品価格への反映は、顧客にもお伝えし、若干だが受け入れていただいている状況。
 - 現時点で見えるリスクは織り込んでいると考える。さらに納期延伸の要請が増え、業績予想の修正を検討するリスクは低いと考えている。

10. SPEの受注が減少傾向にあるが、現時点でボトムアウトはいつ頃と考えるか。
- ボトムアウトの時期を見通すことは難しい。総じて、2023年は軟調な受注環境を想定しているが、7-9月期頃から、Advanced Package, Hybrid Bonding, Wafer on Wafer等の新技術による開発・試作・量産の話材が増加すると想定。
 - 前述の技術において、当社では研削装置が貢献できる。
 - 現時点は試作過程での採用であり、民生需要の減少を補完する規模ではない。
11. 米国CHIPS Act法成立により、2024年に新たな半導体デバイス工場が多数稼働すると思われる。これと、受注ボトムアウト想定時期との関連を確認したい。
- まず、現在の製品納期は、生産スロット調整の影響を除くと、12"プローバで10か月、8"プローバが13か月、ダイサ3-4か月、グラインダ10か月、エッジグラインダで2年程度である。
 - ただし、2023年6月には、飯能工場が稼働する予定であり、部材調達の影響を除くと、2020年度比で2倍の生産能力となり、納期は大幅に短縮できると見ている。
 - このため、2023年7-9月期に受注が回復したとしても、短縮された納期で2024年の半導体デバイス工場の稼働に合わせた出荷が可能と考える。
 - SiCウェーハ関連の研削装置は、そもそも顧客が2年以上先のフォーキャストを前提に発注することも多いうえ、全般に需要が増加傾向にあるので、納期が変化しない可能性もある。
12. 米国の半導体関連輸出規制の強化によるリスクや、想定される影響を聞きたい。
- まず、当社製装置がすぐに中国へ輸出できなくなることは無い。
 - 当該規制により多くの前工程装置の輸出が制限された場合、現地での半導体デバイスの開発・生産が停滞することとなる。そうなれば、当社のような後工程装置の需要にも影響があると考えられる。
 - 現在の中国案件の半分はこういったリスクを内包していると考えられる。ローエンド需要も一定程度あるものの、2020-2021年頃の勢いは無くなるかもしれない。
13. 充放電試験システムの現況と、自動車業界向け計測機器の見通しを聞きたい。
- 当事業の受託測定ビジネスは黒字に転換し、改造・アップグレードビジネスも黒字転換の見込みが立っている。システム販売については、新製品の開発が下期に完了し、2023年度上期の市場投入を計画している。
 - 自動車業界向けは、緩やかな回復基調が続く。ただし、ICE(内燃機関)向けの大規模投資計画は無い状態が続いており、高い更新需要や改修需要が補完している。

内燃機関需要が 2018 年度頃の既往ピーク水準に回復する可能性は低いと考えている。

- 電動化は不可逆的に加速しており、開発・試作投資が増えている。大別するとバッテリー測定(電気測定、内部欠陥測定)、モータ測定(非接触測定)、ならびにギア測定(表面性状の高精度測定)に関連した引合や受注を受けている。
- ICE エンジン関連の測定需要の減少は避けられないが、計測の需要そのものなくなることは無いと考えている。

14. 説明会資料で、SPE の非接触計測機ビルトインを紹介している。詳細を聞きたい。

- 今回はプローバ、ダイサへの非接触機ビルトインを紹介した。従来からインスペクション機能は搭載されており、プローバでは電気計測後の針跡形状の評価、ダイサでは加工後の断面形状を評価できるものの、いずれも 2 次元での測定とどまり、詳細評価は別の装置を使った評価が必要となる。
- 今回のビルトイン機では装置上で 3 次元評価を実現する。電気計測後の針跡の形状や、バンプ形状の 3 次元測定を可能とする。ダイサの場合は表裏面のダイシング深さを検出しなければならないケースで溝の深さまで評価が可能となる。後工程の革新でダイシング深さの管理が必要となれば商機になると考える。
- これらはいずれも市場に出し始めている。

以上